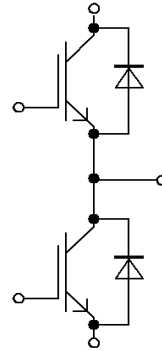


XHP™3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode
 XHP™3 module with Trench/Fieldstop IGBT3 and Emitter Controlled 3 diode



$V_{CES} = 3300V$
 $I_{C\ nom} = 450A / I_{CRM} = 900A$

Potentielle Anwendungen

- Mittelspannungsantriebe
- Motorantriebe
- Traktionsumrichter
- USV-Systeme
- Windgeneratoren

Potential Applications

- Medium voltage converters
- Motor drives
- Traction drives
- UPS systems
- Wind turbines

Elektrische Eigenschaften

- Große DC-Festigkeit
- Hohe Kurzschlussrobustheit
- Niedrige Schaltverluste
- Niedriges V_{CEsat}
- Sehr große Robustheit
- $T_{vj\ op} = 150^{\circ}C$
- V_{CEsat} mit positivem Temperaturkoeffizienten

Electrical Features

- High DC stability
- High short-circuit capability
- Low switching losses
- Low V_{CEsat}
- Unbeatable robustness
- $T_{vj\ op} = 150^{\circ}C$
- V_{CEsat} with positive temperature coefficient

Mechanische Eigenschaften

- AlSiC Bodenplatte für erhöhte thermische Lastwechselfestigkeit
- Gehäuse mit CTI > 600
- Isolierte Bodenplatte

Mechanical Features

- AlSiC base plate for increased thermal cycling capability
- Package with CTI > 600
- Isolated base plate

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code

| Content of the Code | Digit |
|----------------------------|---------|
| Module Serial Number | 1 - 5 |
| Module Material Number | 6 - 11 |
| Production Order Number | 12 - 19 |
| Datecode (Production Year) | 20 - 21 |
| Datecode (Production Week) | 22 - 23 |

IGBT, Wechselrichter / IGBT, Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------|---|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | V_{CES} | 3300 3300 | V |
| Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current | $T_C = 100^{\circ}\text{C}$, $T_{vj\max} = 150^{\circ}\text{C}$ | I_{CDC} | 450 | A |
| Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current | $t_P = 1\text{ ms}$ | I_{CRM} | 900 | A |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage | | V_{GES} | +/-20 | V |

Charakteristische Werte / Characteristic Values

| | | | min. | typ. | max. | |
|---|---|---|---------------------|----------------------|--------------|---|
| Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage | $I_C = 450\text{ A}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $V_{CE\text{ sat}}$ | 2,50 2,90 3,00 | 2,75 3,30 | V V V |
| Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage | $I_C = 12,0\text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | V_{GEth} | 5,20 | 5,80 | 6,40 V |
| Gateladung Gate charge | $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$ | | Q_G | 12,5 | | μC |
| Interner Gatewiderstand Internal gate resistor | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | R_{Gint} | 1,3 | | Ω |
| Eingangskapazität Input capacitance | $f = 1000\text{ kHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$ | | C_{ies} | 84,0 | | nF |
| Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance | $f = 1000\text{ kHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$ | | C_{res} | 2,00 | | nF |
| Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current | $V_{CE} = 3300\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | I_{CES} | | 5,0 | mA |
| Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current | $V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = 20\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | I_{GES} | | 400 | nA |
| Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load | $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 0,7\ \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | t_{don} | 0,53 0,57 0,58 | | μs μs μs |
| Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load | $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 0,7\ \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | t_r | 0,10 0,13 0,13 | | μs μs μs |
| Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load | $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 3,3\ \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | t_{doff} | 1,71 1,86 1,92 | | μs μs μs |
| Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load | $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 3,3\ \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | t_f | 0,13 0,24 0,27 | | μs μs μs |
| Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse | $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$, $L\sigma = 85\text{ nH}$ $di/dt = 3650\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$) $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 0,7\ \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | E_{on} | 500 765 845 | | mJ mJ mJ |
| Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse | $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$, $L\sigma = 85\text{ nH}$ $du/dt = 2850\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$) $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 3,3\ \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | E_{off} | 415 610 670 | | mJ mJ mJ |
| Kurzschlußverhalten SC data | $V_{GE} \leq 15\text{ V}$, $V_{CC} = 2500\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\ \mu\text{s}$, $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | | I_{SC} | 1800 | | A |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case | pro IGBT / per IGBT | | R_{thJC} | | 28,4 | K/kW |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink | pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | | R_{thCH} | 17,4 | | K/kW |
| Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions | | | $T_{vj\text{ op}}$ | -40 | 150 | $^{\circ}\text{C}$ |

Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

| | | | | |
|---|--|---------------|--------------|--|
| Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | V_{RRM} | 3300 3300 | V |
| Dauergleichstrom Continuous DC forward current | | I_F | 450 | A |
| Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current | $t_P = 1\text{ ms}$ | I_{FRM} | 900 | A |
| Grenzlastintegral I^2t - value | $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | I^2t | 82,9 68,0 | kA^2s kA^2s |
| Spitzenverlustleistung Maximum power dissipation | $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | P_{RQM} | 1000 | kW |
| Mindesteinschaltzeit Minimum turn-on time | | $t_{on\ min}$ | 10,0 | μs |

Charakteristische Werte / Characteristic Values

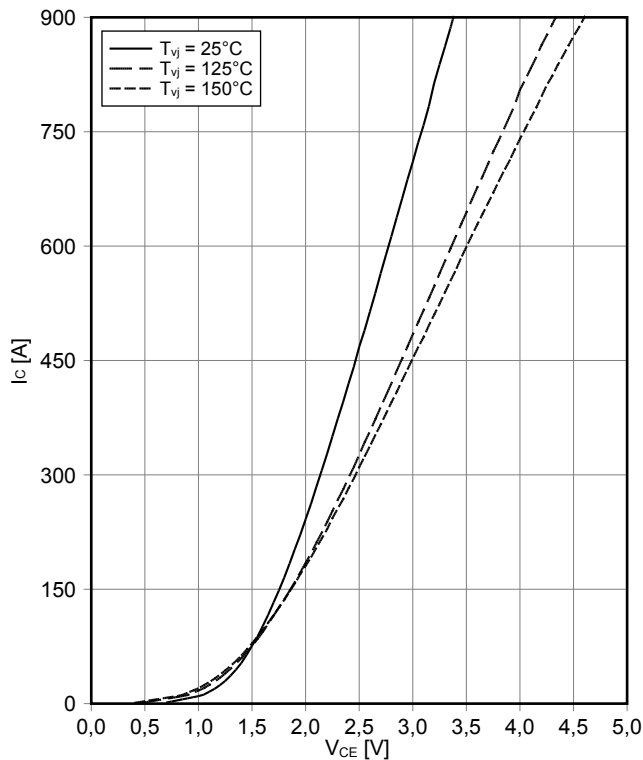
| | | min. | typ. | max. | |
|---|---|--------------|------|------|--------------------|
| Durchlassspannung Forward voltage | $I_F = 450\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | 3,10 | 3,50 | V |
| | $I_F = 450\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | | 2,75 | | V |
| | $I_F = 450\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | | 2,65 | 2,95 | V |
| Rückstromspitze Peak reverse recovery current | $I_F = 450\text{ A}, -di_F/dt = 3650\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | 680 | | A |
| | $V_R = 1800\text{ V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | | 680 | | A |
| | $V_{GE} = -15\text{ V}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | | 680 | | A |
| Sperrverzögerungsladung Recovered charge | $I_F = 450\text{ A}, -di_F/dt = 3650\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | 230 | | μC |
| | $V_R = 1800\text{ V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | | 445 | | μC |
| | $V_{GE} = -15\text{ V}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | | 525 | | μC |
| Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy | $I_F = 450\text{ A}, -di_F/dt = 3650\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | 220 | | mJ |
| | $V_R = 1800\text{ V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | | 490 | | mJ |
| | $V_{GE} = -15\text{ V}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | | 595 | | mJ |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case | pro Diode / per diode | R_{thJC} | | 45,5 | K/kW |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | R_{thCH} | | 19,3 | K/kW |
| Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions | | $T_{vj\ op}$ | -40 | 150 | $^{\circ}\text{C}$ |

Modul / Module

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|--------------|------|----|
| Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage | RMS, f = 50 Hz, t = 10 s | V _{ISOL} | 6,0 | | | kV |
| Teilentladungs-Aussetzspannung Partial discharge extinction voltage | RMS, f = 50 Hz, Q _{PD} ≤ 10 pC | V _{ISOL} | 2,6 | | | kV |
| Material Modulgrundplatte Material of module baseplate | | | AISIC | | | |
| Kriechstrecke Creepage distance | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal | | 53,0 | | | mm |
| Luftstrecke Clearance | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal | | 26,0 | | | mm |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index | | CTI | > 600 | | | |
| | | | min. | typ. | max. | |
| Modulstreuinduktivität Stray inductance module | | L _{sCE} | | 25 | | nH |
| Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip | T _C = 25°C, pro Schalter / per switch | R _{CC'+EE'} R _{AA'+CC'} | | 0,41 0,31 | | mΩ |
| Lagertemperatur Storage temperature | | T _{stg} | -40 | | 150 | °C |
| Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting | Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note | M | 4,25 | | 5,75 | Nm |
| Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse Terminal connection torque | Schraube M8 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M8 - Mounting according to valid application note | M | 8,0 | - | 10 | Nm |
| | Schraube M3 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M3 - Mounting according to valid application note | | 0,9 | - | 1,1 | Nm |
| Gewicht Weight | | G | | 700 | | g |

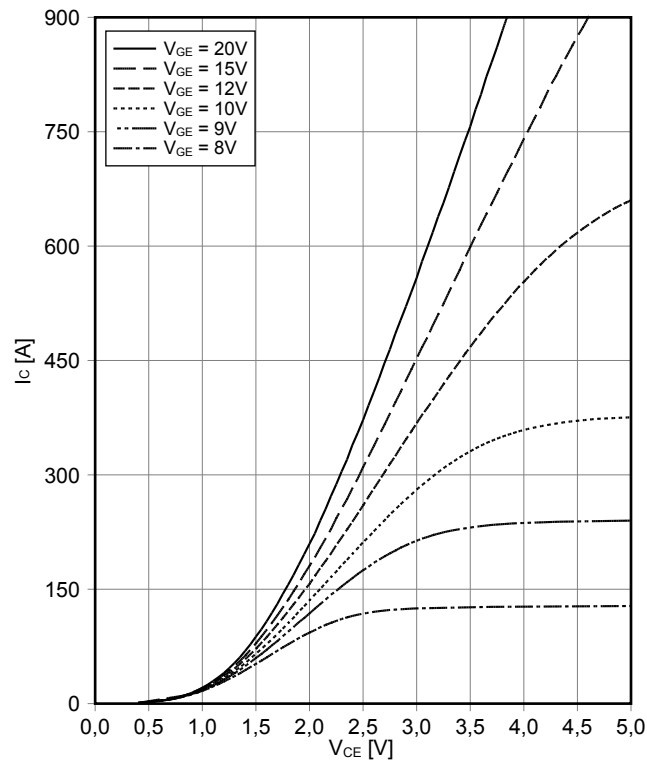
Ausgangskennlinie IGBT, Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



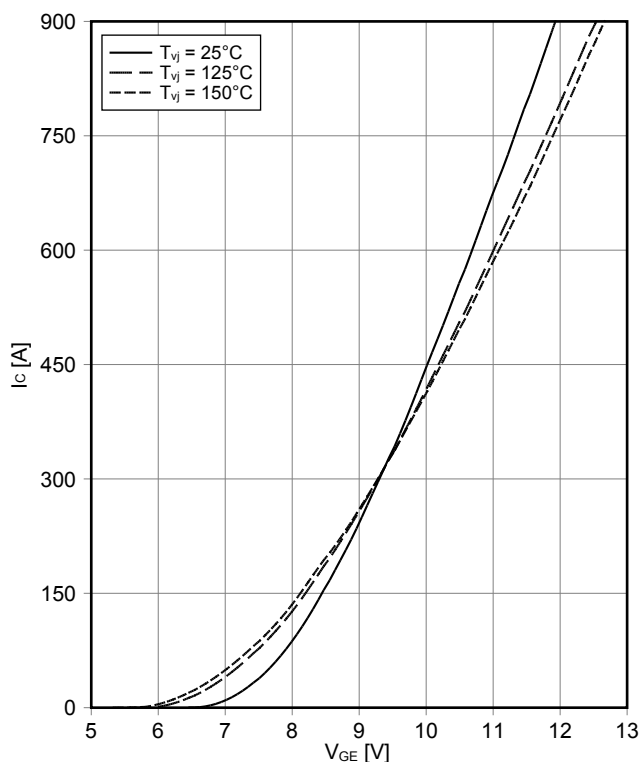
Ausgangskennlinienfeld IGBT, Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



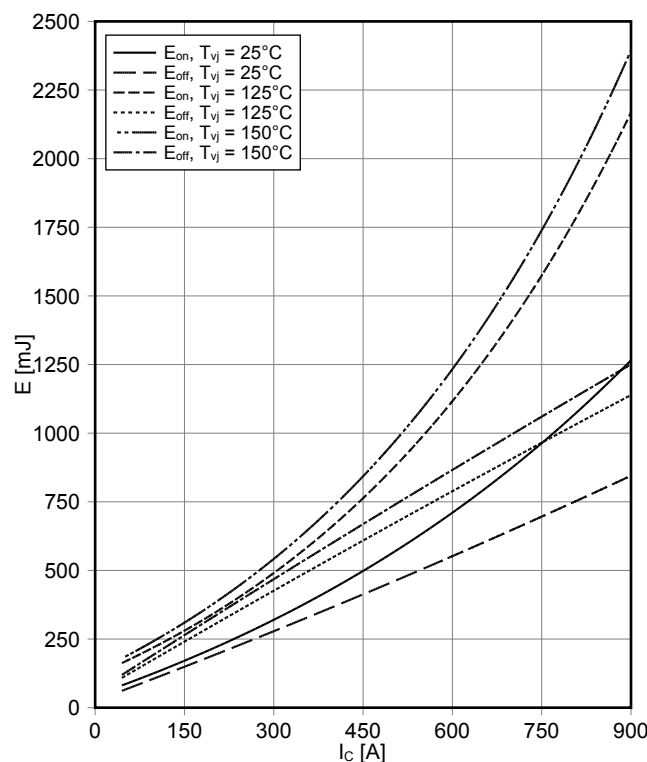
Übertragungscharakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)
transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



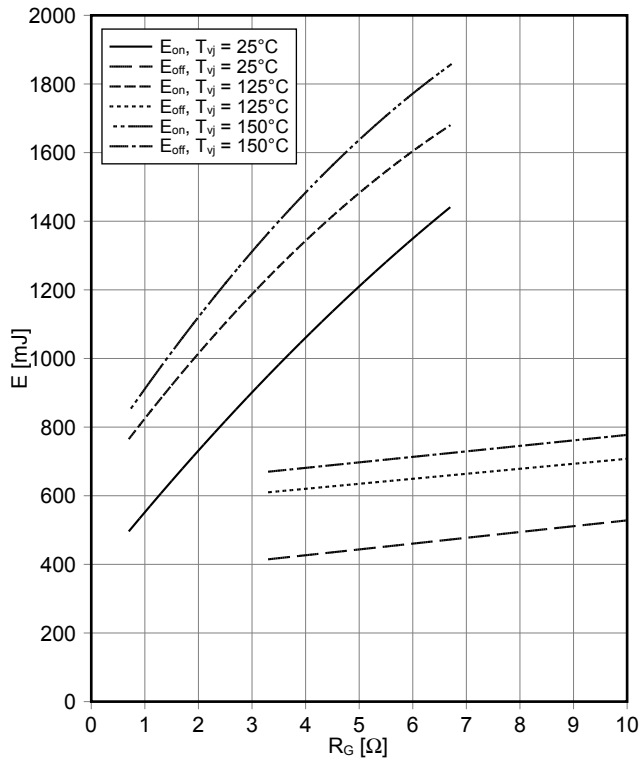
Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 0.7\ \Omega$, $R_{Goff} = 3.3\ \Omega$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$



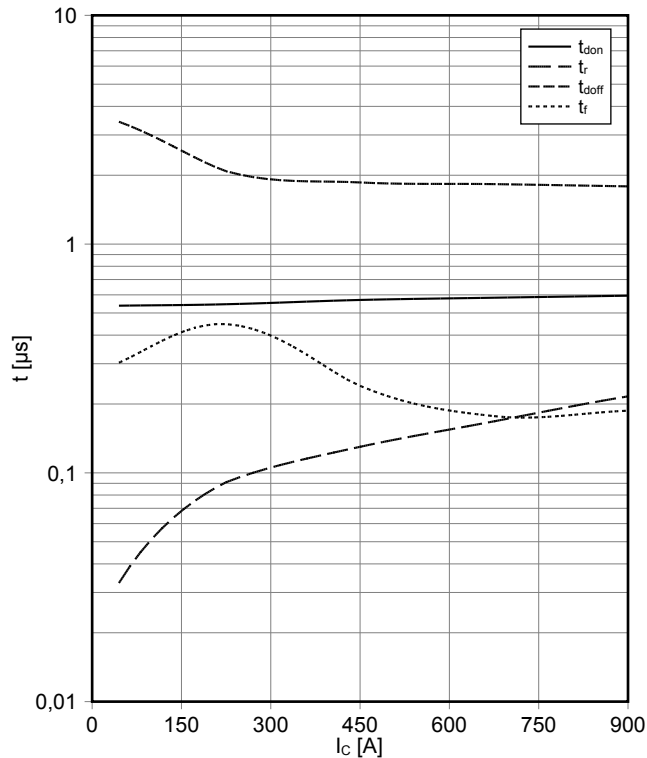
Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch) switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$



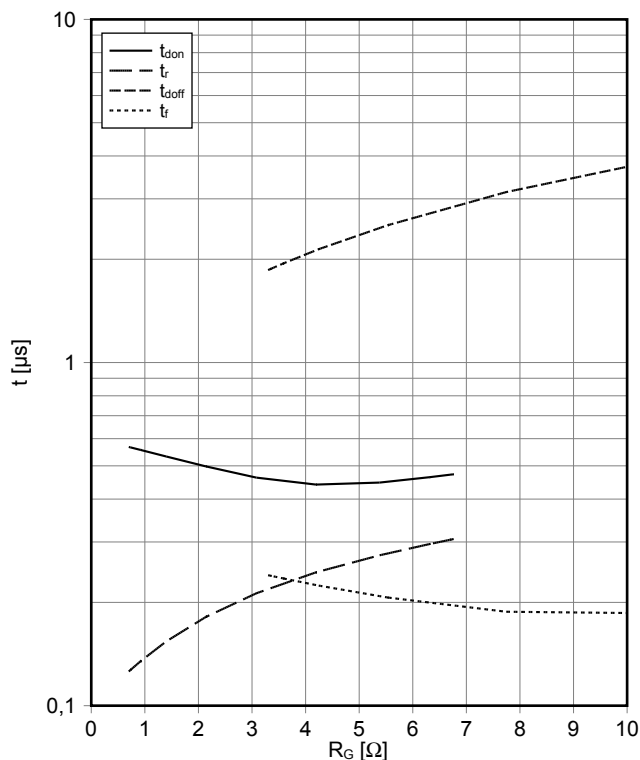
Schaltzeiten IGBT, Wechselrichter (typisch) switching times IGBT, Inverter (typical)

$t_{don} = f(I_C)$, $t_r = f(I_C)$, $t_{doff} = f(I_C)$, $t_f = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 0.7\ \Omega$, $R_{Goff} = 3.3\ \Omega$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



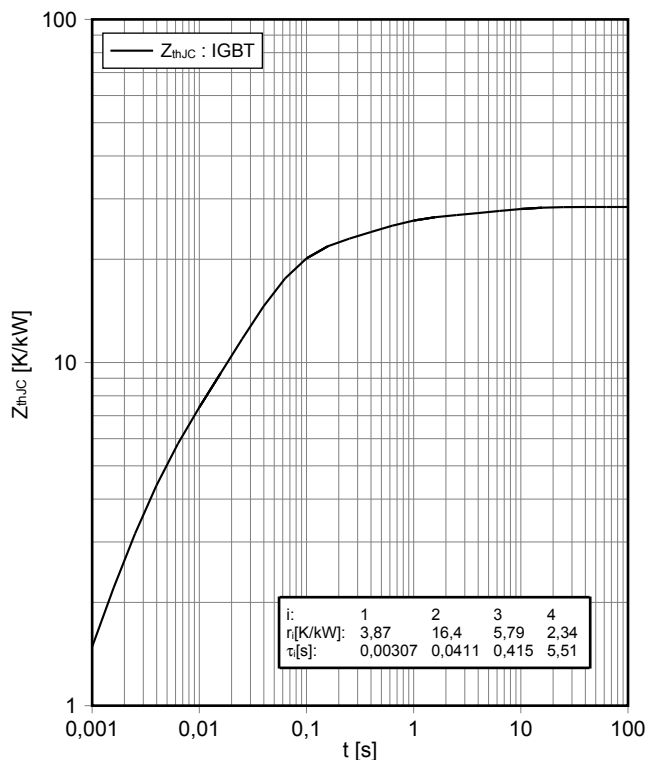
Schaltzeiten IGBT, Wechselrichter (typisch) switching times IGBT, Inverter (typical)

$t_{don} = f(R_G)$, $t_r = f(R_G)$, $t_{doff} = f(R_G)$, $t_f = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



Transienter Wärmewiderstand IGBT, Wechselrichter transient thermal impedance IGBT, Inverter

$Z_{thJC} = f(t)$

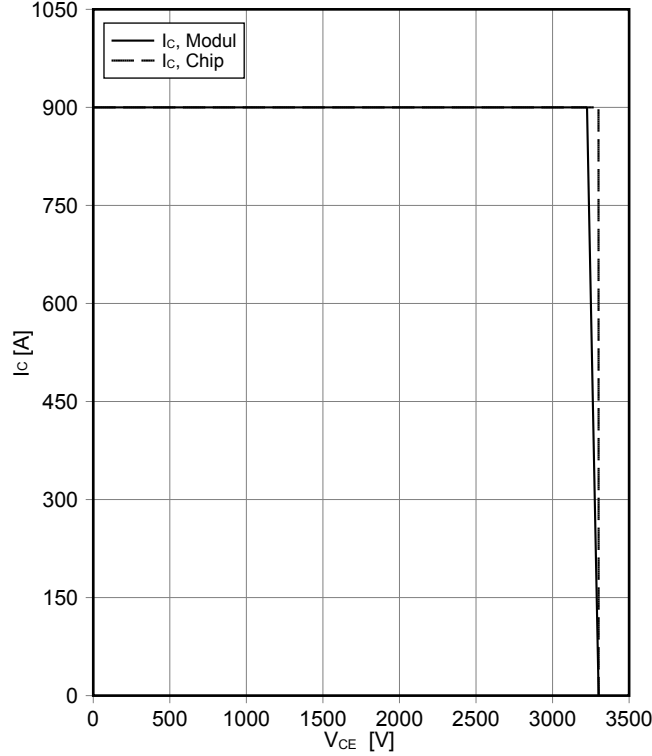


Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT, Wechselrichter (RBSOA)

reverse bias safe operating area IGBT, Inverter (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 3.3\ \Omega$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

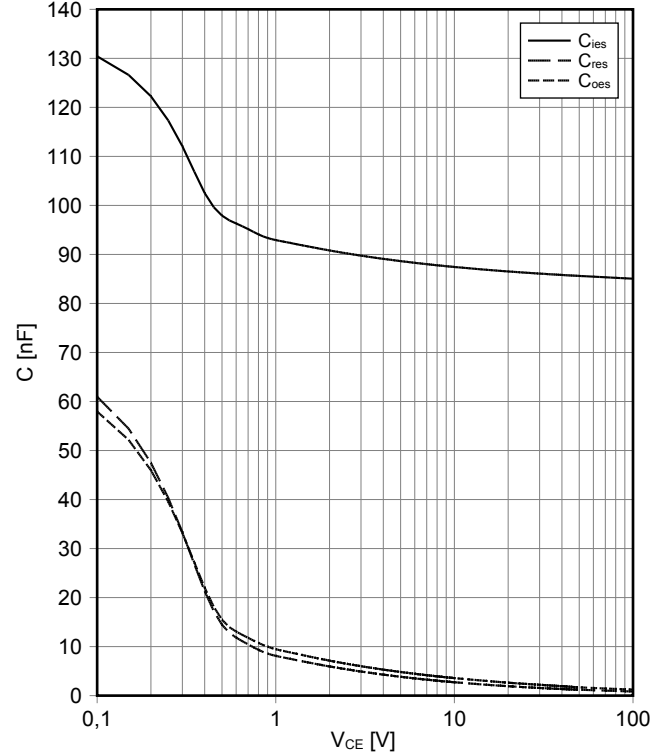


Kapazitäts Charakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)

capacity characteristic IGBT, Inverter (typical)

$C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $f = 100\text{ kHz}$

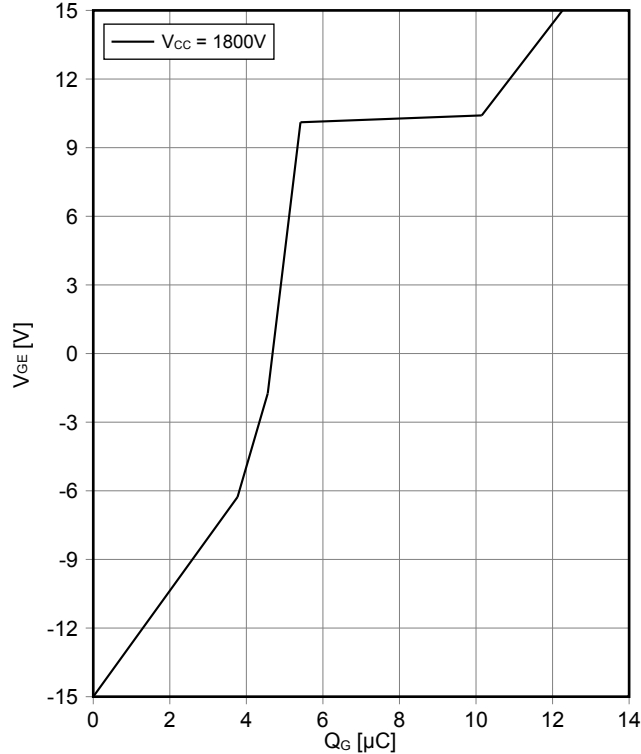


Gateladungs Charakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)

gate charge characteristic IGBT, Inverter (typical)

$V_{GE} = f(Q_G)$

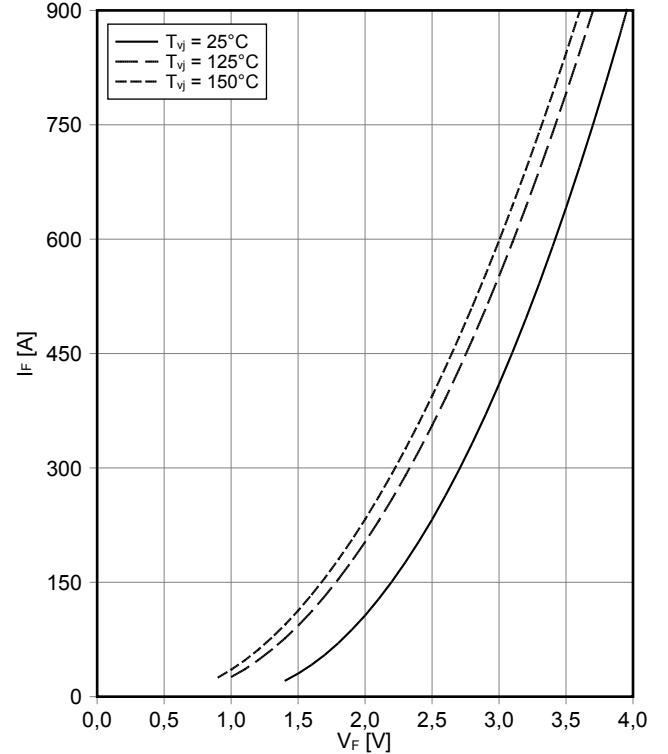
$I_C = 450\text{ A}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)

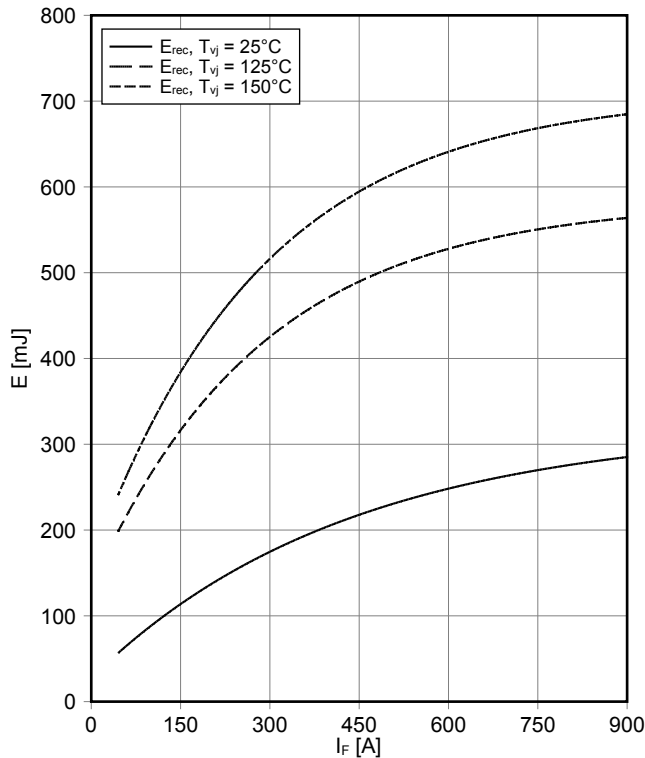
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

$I_F = f(V_F)$



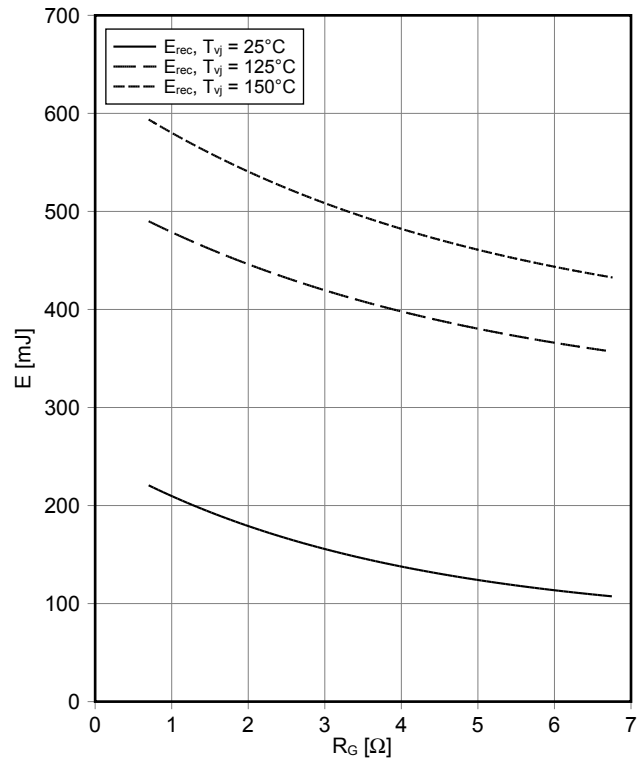
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch) switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 0.7 \Omega, V_{CE} = 1800 V$



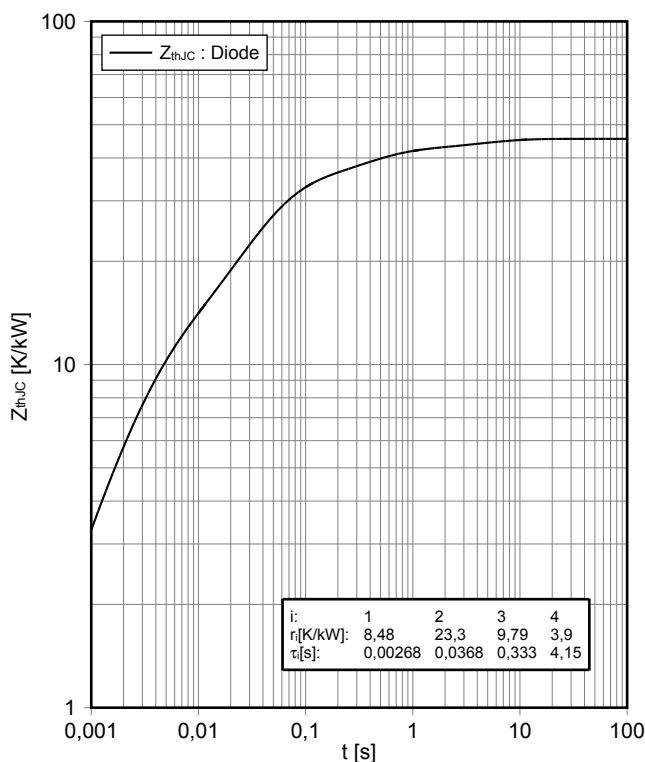
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch) switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 450 A, V_{CE} = 1800 V$



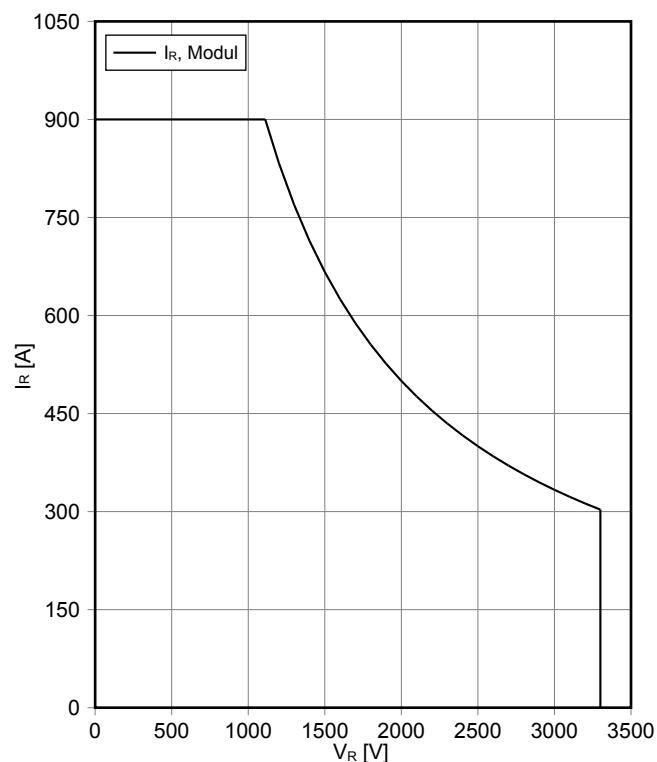
Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter transient thermal impedance Diode, Inverter

$Z_{thJC} = f(t)$

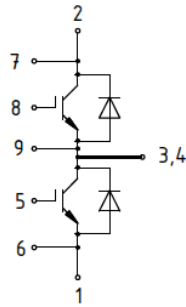


Sicherer Arbeitsbereich Diode, Wechselrichter (SOA) safe operation area Diode, Inverter (SOA)

$I_R = f(V_R)$
 $T_{vj} = 150^\circ C$

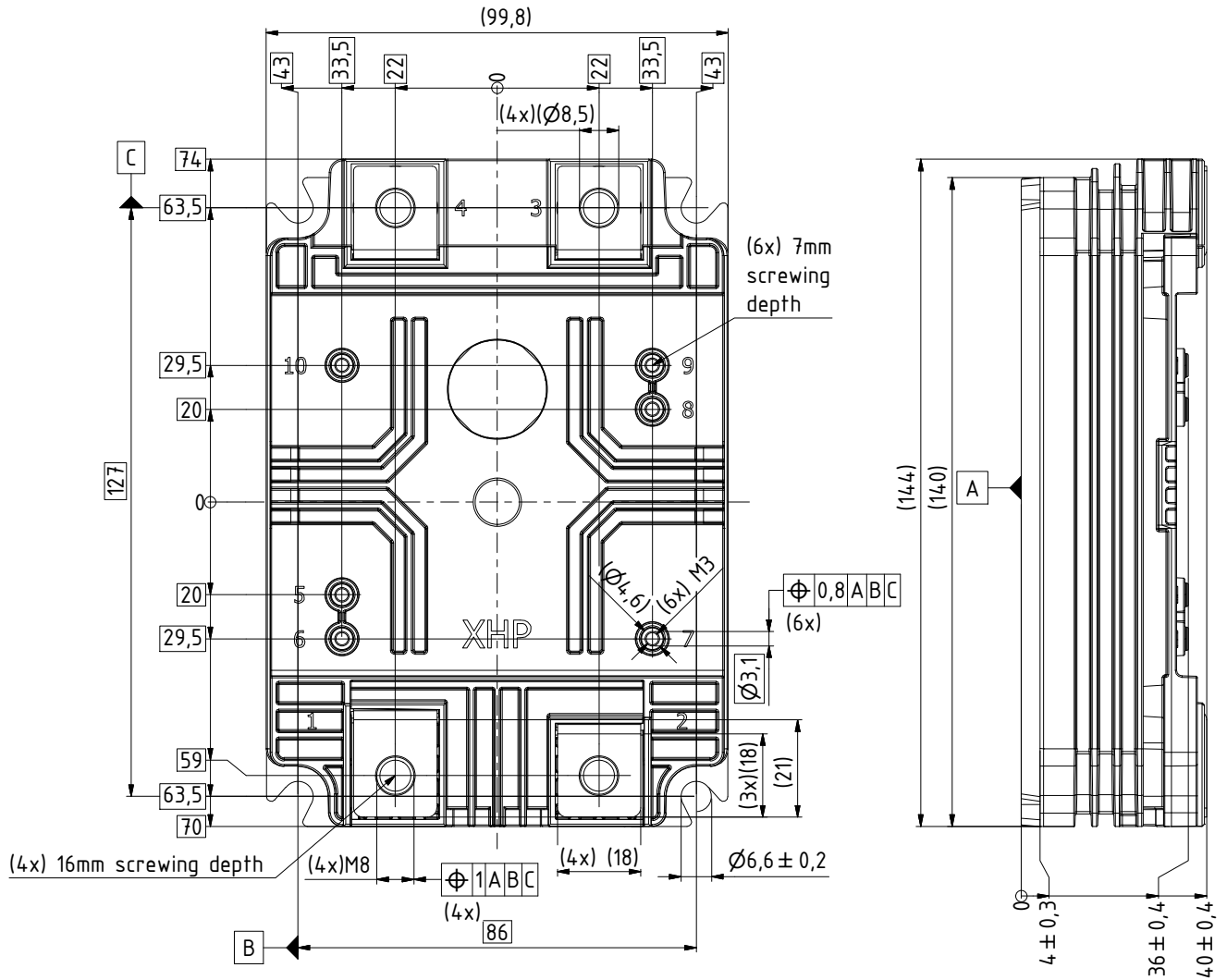


Schaltplan / Circuit diagram



10: NC

Gehäuseabmessungen / Package outlines



Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2018-12-13

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 München, Germany**

**© 2018 Infineon Technologies AG.
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about this document?
Email: erratum@infineon.com**

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Infineon Technologies (www.infineon.com).

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru